

株主メモ

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月
1単元の株式数	100株
配当金受領株主確定日	3月31日 中間配当を行う場合は9月30日
基準日	定時株主総会については3月31日、その他必要ある場合はあらかじめ公告する一定の日
名義書換代理人	UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番3号
同事務取扱場所	UFJ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 電話 06-6229-3011(代表) 株式関係のお手続き用紙のご請求は、次のUFJ信託銀行株式会社の電話及びインターネットでも24時間承っております。 電話 0120-24-4479(本店証券代行部) 0120-68-4479(大阪支店証券代行部) URL http://www.ufjtrustbank.co.jp/
同取次所	UFJ信託銀行株式会社 全国本支店
決算公告	新聞に決算公告は掲載いたしません。 弊社ホームページをご覧ください。 (http://www.mec-co.com/jp/zaimu/)
上場証券取引所	東京証券取引所第二部 大阪証券取引所ヘラクレス市場
証券コード	4971

免責条項

本報告書に記載している将来に関する予想については、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています。実際の業績は、さまざまな要因の変化により、異なる場合があることをご承知おきください。



メック株式会社

本社事務所 / 〒660-0881
兵庫県尼崎市昭和通3丁目95番地アマックスビル 8階
TEL. 06-6414-3451(代) FAX. 06-6414-3455

URL <http://www.mec-co.com/jp/>



メック株式会社

証券コード：4971

第36期 事業報告書

2004年4月1日から2005年3月31日まで

トップインタビュー	◆	1~2
strategy-1 製品戦略と研究開発	◆	3~4
strategy-2 グローバル戦略	◆	5~6
界面の可能性を創造する	◆	7~8
連結財務諸表	◆	9~11
個別財務諸表	◆	12
会社概要 / 株式の状況	◆	13~14



トップインタビュー ◆ 株主・投資家のみなさまへ

36期の業績概況は？

一部のデジタル家電で在庫調整の動きがあり、国内需要が鈍化傾向をたどるなか、電子基板用薬品の新製品開発と販売拡大に注力しました。

当期の世界経済を概観しますと、前半は中国を中心とするアジア経済の拡大や、米国の経済回復などにより、設備投資や個人消費は比較的順調に推移しました。しかし米国大統領選挙の行われた中盤以降は景気の踊り場に入り、原油価格の高騰や雇用状況の不透明感も顕在化しました。電子機器産業においても、車搭載機器の伸張は続いたものの、一部のデジタル家電では在庫調整の動きがあり、需要が鈍化傾向をたどりました。

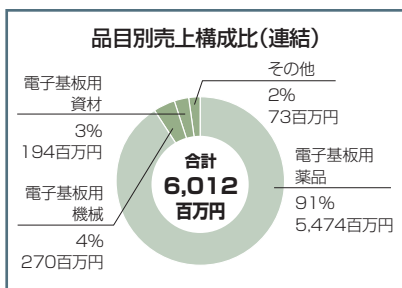
そのため電子基板市場は、前半は全体として好調でしたが、後半になると、分野間、企業間の好不調の格差が明確化しました。また、パッケージ基板やポリイミドベース基板等の高密度多層電子基板以外では、生産拠点の中国への流出が顕著になりました。このような状況の下、当社におきま

ては、電子基板用薬品の新製品開発とその販売拡大に注力しました。その結果、当期の連結売上高は60億12百万円(前期比2.8%増)、同経常利益は10億51百万円(前期比11.1%増)、当期純利益は6億76百万円(前期比14.9%増)となりました。

製品別業績の概況は？

MPUパッケージ基板向けCZ-8101をはじめ、汎用多層基板向けBOシリーズ、ポリイミドベース基板用CHシリーズの拡販が好調です。

品目別売上構成の推移を連結ベースで見ますと、当社の主力製品である薬品の比率が年々上昇しており、当期において全体の91.0%を占めました。なかでも銅表面処理剤の比率が上昇し、全薬品に占める割合は68.1%となりました。販売面に関しては、MPUパッケージ基板向け次世代超粗化剤のCZ-8101の拡販が好調で、従来品のCZ-8100との売上げ比率はほぼ1:3にまで上昇しました。また、汎用多層基板向けの黒化処理代替薬品BOシリーズについては、有力顧客へ向けて量産体制に入り、



高細線ポリイミドベース基板用薬品CHシリーズについても新規採用があり、下半期に入っても好調に推移しました。今後、さらなる拡販を進めていく方針です。

企業価値を高める取り組みは？

CSR憲章の制定や環境会計の導入に着手したほか、コーポレート・ガバナンスの強化を目的とした、継続的な取り組みを行っています。

当社は、ユビキタス社会の実現に向け、社会に対する責任を果たし、社会から信頼される企業であり続けることが重要であると認識しています。そのため企業統治(コーポレート・ガバナンス)を強化しながら、継続的な取り組みにより企業価値の増大をはかっています。その一環として現在、CSR(企業の社会的責任)に関する理念を明示したCSR憲章を作成中です。また、社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取り組みを効率的、効果的に推進していくことを目的に、環境会計の導入も進めています。

今後の配当政策については？

事業投資のための内部留保を充実させながら、安定的な配当も重視してまいります。

当社としましては、「さらなる発展と成長」という株主の皆さまのご期待にできるだけお応えしたいと考えております。したがって配当政

策につきましては、事業投資のための内部留保を充実させながら、安定的な配当を継続してまいります。また、当社は長期的展望に基づいて事業規模の拡大を図っておりますが、そうした当社を長い目で見ていただける株主の皆さまを大切にするとともに、配当政策についても検討してまいります。

今後の事業展望については？

アジア市場を中心に「メックグループの販売力強化」を進めるとともに、ポリイミドベース基板向け製品のさらなる拡販に努めていきます。

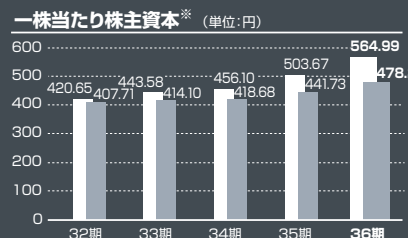
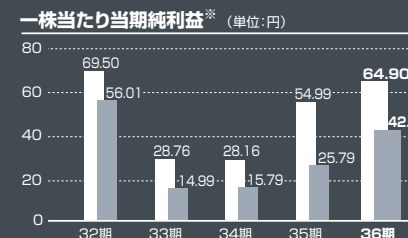
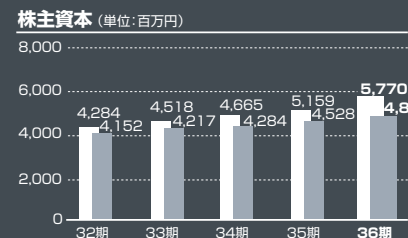
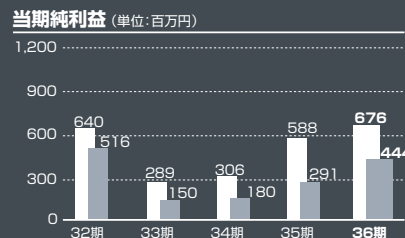
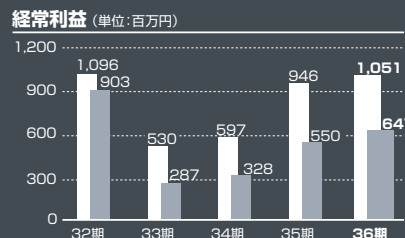
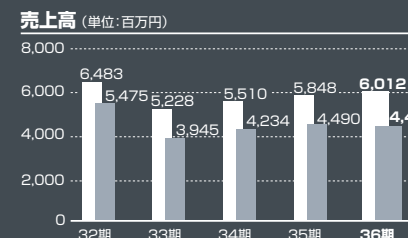
今後の事業展開については、「メックグループの販売力強化」をテーマに、日本、中国、台湾、韓国をひとつのアジア市場とらえて経営資源を集中させていきます。また従来から力を注いできたポリイミドベース基板製造用薬品のさらなる拡販に努めていきます。このほか近い将来に大きさが0.4mm×0.2mmという非常に小さな部品を搭載するため高精細化が進んでいる一般電子基板や、これからますます需要拡大が期待される金メッキ仕上げの電子基板向け製品の開発にも注力したいと考えています。株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長
前田 和夫

財務ハイライト

■ 連結 ■ 単体



*平成16年5月20日付で、1株につき、2株の株式分割を実施いたしました。株式分割が平成12年4月1日に実施されたものとして遡及修正を行った場合の数値としています。

ニーズを取り込みシーズを発信する
メックのマーケティング体制

取締役兼専務執行役員 内野 登一



電子基板メーカーのみならず、エンドユーザーの
要求品質や最新技術もウォッチしながら、
開発スピードの向上をはかっています。

板市場をリードする新製品の開発と拡販に努めてきました。その成果として当期は、高密度基板向けCZシリーズの新製品をはじめ、配線パターン高密度化に対応するポリイミドベース基板向けCHシリーズなどの普及拡大が進みました。今後の市場の動きとしては、次世代半導体「セル(Cell)」やデュアルコアプロセッサの量産体制が来期以降に始まる見込みで、これらデバイスを搭載するパッケージ基板もさらに多層化、高精細化していきます。これを当社製品の需要が増大するチャンスと見て、次々世代のパッケージ基板製造用薬品や最終仕上げ銅表面保護剤の開発にさらに注力してまいります。

高精細基板向け薬品で培った技術の「水平展開」

「界面創造」という技術コンセプトのもと、
電子基板以外のデバイス向けの製品開発にも
積極的に取り組んでいます。

当社ではこれまで技術的な最先端領域である高密度電子基板向け、とりわけMPUパッケージ基板向けの製品開発などを通じて蓄積してきた技術・ノウハウをベースにした、事業領域の水平展開を中長期的な視野から推進しています。また「界面創造」という技術コンセプトのもと、電子基板以外のデバイス向け製品開発にも積極的に取り組んでおり、その結果、当期の新製品開発につきましては、35件の特許を出願しました。

これまで世界の電子基板業界市場において、銅の表面処理を核にした技術力でオンリーワン、ナンバーワンの領域確保を進めてきた当社にとって、研究開発は競争力の源泉です。そのためこれまで一貫して単体売上高の約10%を研究開発費に投入してきました。さらには顧客ニーズをいち早く把握し、シーズを発信するため、マーケティング手法を取り込んで、電子基板メーカーのみならず、電子基板を使用するエンドユーザーや半導体メーカーの要求品質や最新技術をウォッチする体制で臨んでいます。また自社技術のすそ野を広げ、開発スピードの向上をはかることを目的に、大学や研究機関、企業との共同開発にも積極的に取り組んでいます。

国内高密度基板市場での戦略

パッケージ基板のさらなる多層化、高精細化が進むなか、
次々世代のパッケージ基板製造用薬品等の
開発にさらに注力します。

当社がこれまで中長期的に推進してきた事業戦略のひとつに「高付加価値製品の開発」があり、おもに国内市場に向けて、高密度基

粗化密着から高精細対応へ

粗化によらない高密着を実現させる技術を開発。
やがて到来する「フラット」の時代に向けた
取り組みを進めています。

これまでパッケージ基板で行われてきた最先端の表面処理では、銅の表面を粗化する技術が主流でしたが、当社研究所では、粗化によらない高密着を実現させる技術を開発。現在、その実用化をめざした取り組みが進んでいます。MPUの性能がより高くなることから、パッケージ基板に用いる表面処理は「粗化」から「フラット」の時代が来ると予想されています。



CZ-8100で
処理された銅表面

CZ-8101で
処理された銅表面

ポリイミドベース基板向け製品の開発

需要の急拡大が進むポリイミドベース基板向け
市場において、本格的な拡販と製品の充実化に
取り組んでいます。

現在、国内市場を中心に液晶・PDP薄型テレビ、デジタルカメラ、携帯電話等に搭載する、屈曲可能なポリイミドベース基板の需要が急拡大しています。当社ではこれに先駆けて開発したポリイミドベース基板向け製品の本格的な拡販と製品の充実化に取り組んでいます。現在の量産タイプの基板はもっとも細かいもので配線ピッチが50ミクロンですが、今後さらに高精細化が進めば、当社製品のビジネスチャンスのさらなる拡大が期待されます。

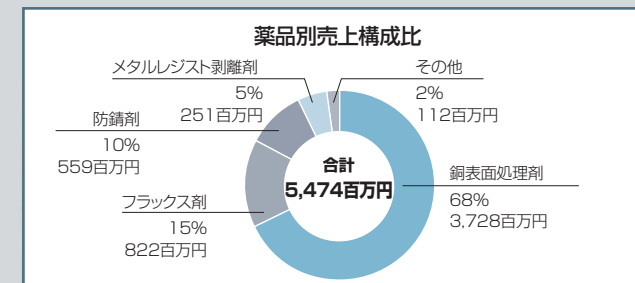


ポリイミドベース基板

汎用多層電子基板向け薬品の開発

黒化処理代替薬品BOシリーズの量産化に向けて始動。
市場拡大が続く中国では、現地の要求に即した
製品の開発に注力します。

汎用基板についてもできるだけ付加価値の高い製品を提供するとの方針に基づき、当社では多層電子基板の一括積層を行う黒化処理代替薬品のBOシリーズを開発。当期はその量産化に向けて動き出しました。また急激な市場拡大が続く中国では、多層基板の需要が拡大していますが、これに対応して研究・製造の人材を派遣し、現地の要求に即した品質と価格の製品開発に注力してまいります。





中国を中心とする東アジア市場に経営資源を集中させ、安定した製品を適正価格で大量に供給する事業展開を進めてまいります。

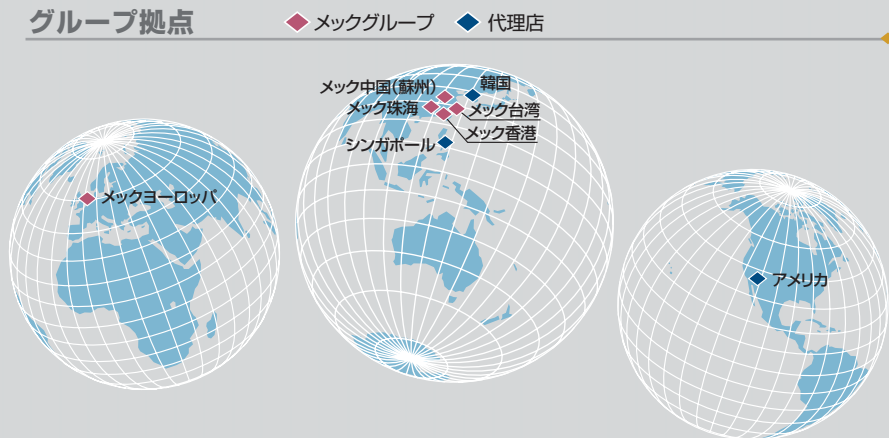
広東省を中心とした「華南」と呼ばれる地域では中国全域の電子基板生産の約7割を占めるとともに、各メーカーが薬品等の関連資材の現地調達を進めています。当社はこの地に販売拠点として1996年に「メック香港」を、2002年には生産・販売拠点として「メック珠海」を設立し、2004年5月から操業を開始しました。一方、電子基板の巨大市場となりつつある「華中」地域の蘇州においても、生産・販売拠点として2001年に「メック中国(蘇州)」を設立。こうして広東省とその周辺の華南地域は、メック珠海とメック香港が、それ以外の上海をはじめ、杭州、無錫、大連、天津、北京などの地域はメック中国(蘇州)がカバーするという「中国二極体制」を形成することで、中国の現地ニーズに柔軟に対応する体制が整いました。

当社のアジアにおける製造・販売拠点として、メック台湾のほか、珠海や蘇州をはじめ、中国国内に三拠点、販売拠点としては韓国に加えて、シンガポールを中心にマレーシア、タイ、フィリピンといった東南アジア地区で、おもに代理店を通した販売活動を行っています。当期はこうした海外子会社、代理店への人材面を中心とした販売力強化と技術支援に注力しました。

なかでも中国へは、世界中から電子基板メーカーが集まり、特に



グループ拠点



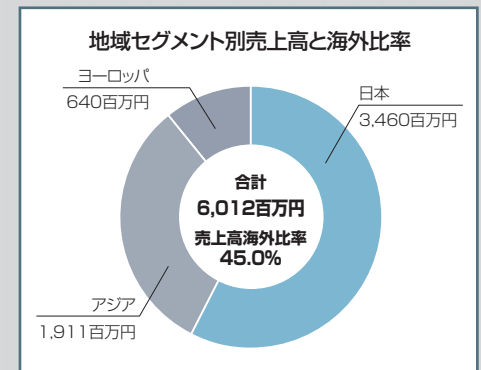
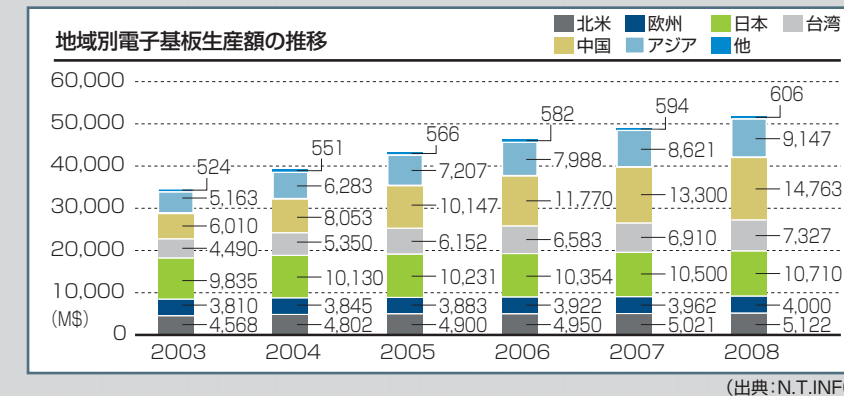
中国国内における製品別の概況を見ますと、世界の生産工場として発展した中国の原動力にもなった「華南」地域では、汎用電子基板向けの銅表面処理剤、最終処理のフラックス剤や防錆剤といった、当社でいえば従来品の需要が高いのが特色となっています。一方、上海や蘇州を中心とした「華中」地域においては、台湾系や日系の企業に加え、近年になって欧州からも高密度多層電子基板のメーカーが進出してきており、こちらではCZシリーズを中心とする銅表面処理剤の需要が高くなっています。当社の事業戦略としましては、東アジアでの顧客開拓に経営資源を集中させるとともに、中国市場へ安定した製品を適正価格で大量に供給することを基本とした事業展開をはかるため、現地のニーズに即した製品開発にも注力していくこととなります。

当期から稼働を開始した珠海工場におきましては、当社の既存のお取引先である技術力の高い日系企業を中心とした製品供給に重点を置きながらも、立ち上げ当初は台湾や蘇州、日本から原材料の供給を受けていました。それが現在では原材料を現地で調達し、生産するという体制が確立し、月産200トン前後の安定した生産を続けており、次なるステップとして販売力のさらなる強化に取り組んでいます。また、メック中国(蘇州)においても生産量のさらなる増大を進めていく方針です。こうして中国における生産体制の拡充を進めることで、30%もの生産量の伸びを続ける中国という成長市場において、着実に「ボリュームゾーン」の獲得をめざしてゆきます。

海外汎用基板市場での戦略

長期的な視野から現在好調な中国市場以外にも目を向けながら、グローバルな顧客の動向に柔軟に対応していきます。

汎用多層電子基板用製品における海外シェア拡大も当社の重要な事業戦略テーマであり、この戦略に基づいて製品開発と拡販に努めた結果、海外売上げ比率は前期40.1%から、当期はアジア、とりわけ中国市場の伸びによって45.0%を占めるまでになりました。中国市場以外では、日本に次ぐ高密度基板を生産している台湾のほか、世界的に有名なメーカーがある韓国についても年々売上げ上昇の方向にあり、今後ともさらなる市場深耕に取り組んでまいります。このほかベルギーに生産・販売拠点を置く欧州市場では、車載用基板を中心としたドイツで需要拡大が期待できるほか、トルコ、ロシア、ベラルーシといった国々で安定した需要が継続しています。今後も中国を含めた東アジアへの積極投資を進める方針に変わりはありませんが、他地域も含めグローバルにアンテナを張りながら、世界各地の市場や生産拠点の動向をキャッチして、顧客の動きに柔軟に対応していきたいと考えています。



界面の可能性を創造する

新製品ができるまで

デザインレビューフロー図

① テーマの決定:DR-0

デザインレビュー(DR-0): 仕様決定会議

製品化の第一関門であるテーマを決定します。



② R&D:DR-1

デザインレビュー(DR-1): 仕様確認会議

評価基準をクリアしているか確認します。



③ 製品化:DR-2

デザインレビュー(DR-2): ユーザーでの設計妥当性確認会議

顧客先で量産試験を行い、製品化の是非を判定します。



研究開発センターの組織

- ◆ 研究開発センター
 - ◆ 研究・開発
 - ◆ 技術サポート
 - ◆ 品質管理
 - ◆ 特許管理

新製品開発における高効率化への取り組み

品質マネジメントシステムのルールに従って
デザインレビューを実践。複数の顧客と協同体制を
とりながら品質をつくり込んでゆきます。

近年、電子基板の高精細化や配線パターンの微細化が進んでくると、新製品開発において基板製造装置の寸法精度等まで考慮する必要が生じ、基板製造技術も踏まえた顧客との共同開発が必須条件となってきました。そこで新製品開発では、製品が完成してから顧客に提供するのではなく、ISOの品質マネジメントシステムのルールに従ってデザインレビューを実践。「DR-0:仕様決定」から「DR-1:仕様確認」「DR-2:モニター・実験」と3段階の各フェーズで評価・判定を行い、DR-1の段階から複数の顧客と協同体制をとりながら製品完成まで仕上げてゆきます。

コア事業の水平展開

新しい領域での表面処理技術を追究。
異種金属の選択エッチングのほか、樹脂の表面改質にも
取り組んでいます。

これまで当社は銅表面処理技術を核として、主に高精細な電子基板製造用薬品を開発してきました。現在は、そうして培った技術ノウハウを応用し、「界面創造」をコンセプトに、銅に限らず他の金属や樹脂にも広く目を向けて、新しい領域での表面処理技術を追究しています。モノづくりでは異なる物質と物質の境界面が必ずといていほど生じます。今後も界面の信頼性が求められる領域=当社の活躍する領域はさらに広がってゆくものと確信しています。

既存市場の「空白地帯」を埋める事業の推進

顧客の現場に密着し、顧客ニーズにきめ細かくお応えしながら、
製品分野の拡大に努めてゆきます。

成長戦略としての高密度基板と汎用基板の二つの市場における深耕と並行して、当社ではこれら既存市場の空白地帯を埋める事業開拓にも積極的に取り組んできました。近年の事例では、多層電子基板を積層する際の前処理工程で使用する黒化処理代替剤があります。それまでこの工程は作業環境も悪く、かつて当社もまったく

手つかずの領域でしたが、それまで薬品と機械の一体提供を手がけてきたノウハウをもとに、一からの開発に着手。既存の黒化処理装置に薬液を入れ替えるだけで使用でき、コンベア処理により産廃物や水の使用料も低減する環境にやさしい工程が実現しました。今後とも顧客の現場に密着し、顧客ニーズにきめ細かくお応えしながら、製品分野の拡大に努めます。

ポリイミドベース基板の領域開拓

ラインピッチの精細化に対応した製品づくりに取り組むほか、
自社技術の横展開をはかった取り組みにも注力します。

近年から当社が力を注いできたポリイミドベース基板向け薬品は、技術的にはほぼ確立した時期を迎え、今後はいっそう幅広い分野での利用が期待されています。材料メーカーが増産をはじめた来期(37期)夏ごろから本格的な量産体制に入るものと予測しています。今後はさらにラインピッチの精細化に対応した製品づくりに取り組んでゆくほか、ポリイミドベース基板の技術領域で培った技術ノウハウをリジッド基板でも転用。低コスト、高生産性を実現させる製品開発など、自社技術の横展開をはかる取り組みにも注力しています。

